特許協力条約

今後の手続きについては、様式PCT/IPEA/416を参照すること。

PCT

特許性に関する国際予備報告(特許協力条約第二章)

REC'D **28 APR 2005**WIPO PCT

(法第 12 条、法施行規則第 56 条) [PCT36 条及びPCT規則 70]

出願人又は代理人

の普類記号 P00033773-P0	The state of the s				
国際出願番号 PCT/JP2004/004395	国際出願日 (日. 月. 年) 29. 03. 2004	優先日 (日.月.年) 18.04.2003			
国際特許分類(I P C)Int.Cl. ⁷ F16L59/06	G, A47J27/21, 41/00, G03G15/20				
出願人 (氏名又は名称) 松下電器産業株式会社	•				
1. この報告書は、PCT35条に基づき、 法施行規則第57条 (PCT36条)の	規定に従い送付する。	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
2. この国際予備審査報告は、この表紙を	と含めて全部で 4 ペ	ージからなる。			
3. この報告には次の附属物件も添付されている。 a. ▼ 附属書類は全部で 6 ページである。					
1	礎とされた及び/又はこの国際予備審 P C T 規則 70. 16 及び実施細則第 607	査機関が認めた訂正を含む明細書、請求の範 号参照)			
「 第 I 欄 4. 及び補充欄に示 国際予備審査機関が認定し		の開示の範囲を超えた補正を含むものとこの			
b. 「電子媒体は全部で	(電子媒体の種類、数を示す)。				
配列表に関する補充欄に示すように、コンピュータ読み取り可能な形式による配列表又は配列表に関連するテーブルを含む。(実施細則第 802 号参照)					
4. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。					
 ・ 第 I 棚 国際予備審査章 第 I 棚 優先権 第 II 棚 新規性、進歩性 第 IV棚 発明の単一性の 	生又は産業上の利用可能性についての国 の欠如	国際予備審査報告の不作成 の利用可能性についての見解、それを 裏付			

国際予備審査の請求審を受理した日 11.11.2004	国際予備審査報告を作成した日 18.04.2005	
名称及びあて先	特許庁審査官(権限のある職員)	3M 9240
日本国特許庁 (IPEA/JP)	岩谷 一臣	
郵便番号100-8915		
東京都千代田区版が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線	泉 3377

第Ⅰ	棚	報告の基礎
1.	この	国際予備審査報告は、下記に示す場合を除くほか、国際出願の言語を基礎とした。
r		この報告は、 語による翻訳文を基礎とした。 それは、次の目的で提出された翻訳文の言語である。 PCT規則12.3及び23.1(b)にいう国際調査 PCT規則12.4にいう国際公開 PCT規則55.2又は55.3にいう国際予備審査
		報告は下記の出願書類を基礎とした。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に応答するために提出され 用紙は、この報告において「出願時」とし、この報告に添付していない。)
	Г	出願時の国際出願書類
	V	明細書
		第 ページ、出願時に提出されたもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの 第 ページ*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
` .	ᄝ	請求の範囲 項、出願時に提出されたもの 第2-4,10-13,15,17-19,21 項、出願時に提出されたもの 第 項*、PCT19条の規定に基づき補正されたもの 第1,7,14,16,20,22-31 項*、11.11.2004 付けで国際予備審査機関が受理したもの 項*、 付けで国際予備審査機関が受理したもの
	되 -	図面 第 1 - 9
	1	配列表に関する補充欄を参照すること。
3.	짂	補正により、下記の書類が削除された。 □ 明細書 第
4.	_	この報告は、補充欄に示したように、この報告に添付されかつ以下に示した補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。 (PCT規則 70.2(c)) 「明和書 第
*	4.	に該当する場合、その用紙に"superseded"と記入されることがある。

第V欄 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、 それを裏付ける文献及び説明

4	見解
1	兒烨

新規性 (N) 請求の範囲 1-4, 7, 10-31 請求の範囲 __ 進歩性(IS) 請求の範囲 1-4, 7, 10-14, 16, 26, 27 請求の範囲 15, 17-25, 28-31 産業上の利用可能性(IA) 請求の範囲 1-4, 7, 10-31 有 請求の範囲 ___

2. 文献及び説明 (PCT規則 70.7)

文献1: JP 2001-141179 A (松下電器産業株式会社)

2001.05.25,全文,全図

& US 2003-134078 A 1

文献2:JP 2001-265138 A (日本バイリーン株式会社)

2001.09.28,全文,全図

11-280987 A (住友化学工業株式会社) 文献 3 : JP

1999. 10. 15, 全文, 全図

文献4:日本国実用新案登録出願2-107427号(日本国実用新案登録出願公開 4-64089号)の願書に添付した明細書及び図面の内容を記録したマイ

クロフィルム (シャープ株式会社) 1992.06.01,全文,全図 文献5:JP 2003-74786 A (松下冷機株式会社)

2003.03.12,全文、全図

請求の範囲1-4, 7, 10-14, 16, 26, 27に係る発明は、新規性・進 歩性を有する。真空断熱材の熱融着層にフッ素樹脂を採用することで、融点を200 度以上にすると共に難燃性も付加することは、国際調査報告に引用されたいずれの文 献にも記載されておらず、当業者にとって自明なものでもない。

請求の範囲15, 17, 22-24に係る発明は、文献1及び2の記載により進歩性を有しない。文献1には100 \mathbb{C} 程度の熱源に対して真空断熱材を用いることが、文献2には同様に200 \mathbb{C} の熱源に用いることがそれぞれ記載されているので(文献 1の段落【0019】、文献2の段落【0004】)、当業者であれば、これらの記載から100℃を越え200℃未満の熱源に真空断熱材を適用する発明を得ることは 容易に想到する。また、その際、真空断熱材を構成する熱融着層や保護層等の溶融温度を適用する熱源の温度に応じて設定することは当業者にとって当然のことである。

請求の範囲18,19に係る発明は、文献1及び2の記載により進歩性を有しない。 文献2には、定着ローラに真空断熱材を用いることが記載されている(段落【000 2])。

請求の範囲20,21に係る発明は、文献1,2,及び5の記載により進歩性を有しない。文献5には、ノート型パソコンの筐体底面や給湯装置のヒータの近くに真空 断熱材を用いることが記載されており(段落【139】-【143】、第12-14 図)、当業者であれば真空断熱材をこれらの機器に適用することは容易に想到する。

補充概

いずれかの脚の大きさが足りない場合

第 V 棚の続き

請求の範囲25に係る発明は、文献1及び2の記載により進歩性を有しない。保護層にイミド樹脂を用いることは文献1に記載されている(段落【0028】)。

請求の範囲28に係る発明は、文献1及び2の記載により進歩性を有しない。文献1にはシール層4に無延伸ポリプロピレンを用いることが記載されているところ、当該シール層4は熱融着される接着層7を構成している(段落【0017】-【0019】)。したがって、文献1には熱融着層に無延伸ポリプロピレンを用いることが記載されている。

請求の範囲29に係る発明は、文献1,2,及び3の記載により進歩性を有しない。 ガスバリア層として金属を用いることは文献1に記載されているし(段落【0021】 【0028】)、同様にアラミド樹脂を用いることは文献3に記載されている(段落【0047】。

そして、当業者であればこれらの真空断熱材に関する技術を寄せ集めることは容易に 想到する。

請求の範囲 30, 31 に係る発明は、文献 1, 2, 及び 4 の記載により進歩性を有しない。文献 4 には外被材の端面において熱融着層を覆う保護部材を設けることが記載されている(第5 ページ)。

そして、当業者であればこれらの真空断熱材に関する技術を寄せ集めることは容易に 想到する。

請求の範囲

1. (補正後) 芯材と、

5

前記芯材を覆い、

熱溶着層と、

前記熱溶着層の外側に設けたガスバリア層と、

前記ガスバリア層の外側に設けた保護層と、を有する 外被材と、

前記外被材を溶着したヒレ部と、を備え、

前記熱溶着層はフッ素樹脂を含み、かつ融点が200℃以上 10 で、前記ガスバリア層と前記保護層との融点が前記熱溶着層の融点 より高い、

真空断熱材。

- 2. 少なくとも前記保護層がUL94規格VTM-2以上の難燃性を有する材料を含む、
- 15 請求項1記載の真空断熱材。
 - 3. 前記熱溶着層と、前記ガスバリア層とが、UL94規格VTM-2以上の難燃性を有する材料を含む、

請求項2記載の真空断熱材。

4. 前記保護層は、フッ素樹脂と、イミド樹脂との少なくともい 20 ずれかを含む、

請求項1記載の真空断熱材。

- 5. (削除)
- 6. (削除)
- 7.(補正後)前記熱溶着層は、ポリクロロ3ふっ化エチレンを含む、 25 請求項1記載の真空断熱材。
 - 8. (削除)
 - 9. (削除)
 - 10. 少なくとも一面の前記ガスパリア層は、

アラミド樹脂フィルムと、

30 金属、金属酸化物、シリカの少なくともいずれかを含

むガスバリア膜と、を含む、 請求項1記載の真空断熱材。

11. 少なくとも前記外被材の端面において前記熱溶着層を覆い、 UL94規格VTM-2以上の難燃性を有する保護部材と、をさら 5 に備えた、

請求項1記載の真空断熱材。

- 12.前記保護部材は、UL510 FR準拠の粘着テープを含む、 請求項11記載の真空断熱材。
- 13. 前記保護部材は、難燃性シーラーである、
- 10 請求項11記載の真空断熱材。
 - 14. (補正後) 100℃を超え200℃以下の熱源と、 前記熱源の熱により影響を受ける被保護部材と、 芯材と、

前記芯材を覆い、

15 熱溶着層と、

前記熱溶着層の外側に設けたガスバリア層と、 前記ガスバリア層の外側に設けた保護層と、を 有する外被材と、

前記外被材を溶着したヒレ部と、を有し、

20 前記熱溶着層はフッ素樹脂を含み、かつ融点が200℃以上で、前記ガスバリア層と前記保護層との融点が前記熱溶着層の融点より高く、前記熱源からの前記被保護部材への熱影響を遮断する真空断熱材と、を備えた、

機器。

25 15.100℃を超え200℃未満の熱源と、

前記熱源の熱により影響を受ける被保護部材と、

芯材と、

前記芯材を覆い、

熱溶着層と、

30 前記熱溶着層の外側に設けたガスバリア層と、

17

前記ガスバリア層の外側に設けた保護層と、を 有する外被材と、

前記外被材を溶着したヒレ部と、を有し、

前記熱溶着層の融点が100℃を超え200℃未満で、前記 5 保護層の融点が200℃以上であり、少なくとも前記ヒレ部が前記 真空断熱材の断熱面の低温側に配され、前記熱源からの前記被保護 部材への熱影響を遮断する真空断熱材と、を備えた、

機器。

16.(補正後)100℃を超え200℃以下に加熱された被保温部10 と、

芯材と、

前記芯材を覆い、

熱溶着層と、

前記熱溶着層の外側に設けたガスバリア層と、

前記ガスバリア層の外側に設けた保護層と、を有する外被材と、

前記外被材を溶着したヒレ部と、を有し、

前記熱溶着層はフッ素樹脂を含み、かつ融点が200℃以上で、前記ガスバリア層と前記保護層との融点が前記熱溶着層の融点・より高く、前記被保温部の温度状態を保つ真空断熱材と、を備えた、機器。

17.100℃を超え200℃未満に加熱された被保温部と、

芯材と、

前記芯材を覆い、

熱溶着層と、

前記熱溶着層の外側に設けたガスバリア層と、

前記ガスバリア層の外側に設けた保護層と、を有する外被材と、

前記外被材を溶着したヒレ部と、を有し、

前記熱溶着層の融点が100℃を超え200℃未満で、前記

30

25

15

20

保護層の融点が200℃以上であり、少なくとも前記ヒレ部が前記 真空断熱材の断熱面の低温側に配され、前記被保温部の温度状態を 保つ真空断熱材と、を備えた、

機器。

5 18. 前記機器は記録紙にトナーを定着させる印刷装置であり、 前記熱源は前記記録紙に前記トナーを定着させる定着装置で あり、

前記被保護部材は、

前記定着装置により前記記録紙に溶融定着される前記 トナーを収容するトナー収容部と、

> 前記トナーを前記記録紙に転写するための転写装置と、 印刷を制御する制御装置と、であり、

前記真空断熱材は、少なくとも前記定着装置、前記トナー収容部、前記制御装置のいずれかの外周に設けられた、

15 請求項14、15のいずれかに記載の機器。

19. 前記機器は、印刷装置の内部に設けられた、記録紙にトナーを溶融定着するための定着装置であり、

前記被保温部は

前記定着装置内に設けられた熱定着ローラーと、

前記定着装置内に設けられ、前記熱定着ローラーに前 記記録紙を圧接する加圧ローラーと、であり、

前記真空断熱材は、前記熱定着ローラーと前記加圧ローラーとの少なくとも一方を囲むように配設された、

請求項16、17のいずれかに記載の機器。

25 20. (補正後) 前記機器はノート型パソコンであり、

前記熱源はCPUであり、

前記被保護部材は、

前記ノート型パソコンの外殻をなす筐体と、

前記ノート型パソコンから露出したキーボードと、

前記ノート型パソコン内部に設けられた付属内蔵機器

10

20

と、の少なくともいずれかであり、

前記CPUと前記筐体の底面との間、前記CPUと前記キーボードとの間、前記CPUと前記付属内蔵機器との間の少なくともいずれかに、前記真空断熱材を配した、

5 請求項14、15のいずれかに記載の機器。

21. 前記機器は内部に貯湯容器を有する給湯装置であり、

被保温部は前記貯湯容器に近接した湯沸しヒーターであり、

少なくとも前記湯沸しヒーターに近接する部位に前記真空断熱材を配設した、

10 請求項16、17のいずれかに記載の機器。

22. (追加) 芯材と、

前記芯材を覆い、

熱溶着層と、

前記熱溶着層の外側に設けたガスバリア層と、

15 前記ガスバリア層の外側に設けた保護層と、を有する 外被材と、

前記外被材を溶着したヒレ部と、を備え、

前記熱溶着層の融点が100℃を超え200℃未満で、前記保護層の融点が200℃以上であり、少なくとも前記ヒレ部が前記真空断熱材の断熱面の低温側に配された、

真空断熱材。

20

23. (追加)少なくとも前記保護層がUL94規格VTM-2以上の難燃性を有する材料を含む、

請求項22記載の真空断熱材。

25 2 4. (追加)前記熱溶着層と、前記ガスバリア層とが、UL94規格VTM-2以上の難燃性を有する材料を含む、

請求項23記載の真空断熱材。

25. (追加)前記保護層は、フッ素樹脂と、イミド樹脂との少なくともいずれかを含む、

30 請求項22記載の真空断熱材。

- 2 6. (追加) 前記熱溶着層は、フッ素樹脂を含む、 請求項 2 2 記載の真空断熱材。
- 27. (追加)前記熱溶着層は、ポリクロロ3ふっ化エチレンを含む、 請求項26記載の真空断熱材。
- 5 28. (追加)前記熱溶着層は、融点が150℃以上200℃未満である無延伸ポリプロピレンを含む、

請求項22記載の真空断熱材。

29. (追加)少なくとも一面の前記ガスバリア層は、

アラミド樹脂フィルムと、

10 金属、金属酸化物、シリカの少なくともいずれかを含むガスバリア膜と、を含む、

請求項22記載の真空断熱材。

30. (追加)少なくとも前記外被材の端面において前記熱溶着層を 覆い、UL94規格VTM-2以上の難燃性を有する保護部材と、 15 をさらに備えた。

請求項22記載の真空断熱材。

3 1. (追加)前記保護部材は、UL510 FR準拠の粘着テープを含む、

請求項30記載の真空断熱材。